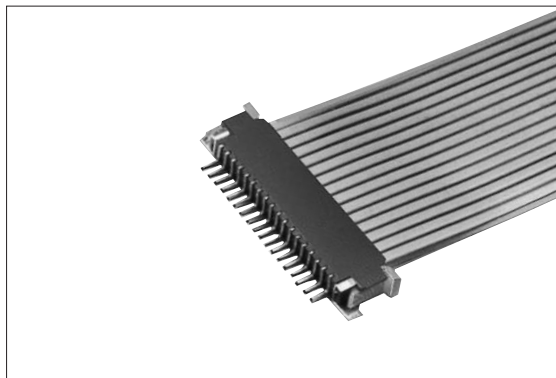


FP-10 ^{SU}_{SL} Series 1.0mm Pitch (SMT)



■ Features

1. Either upper or lower contact available.
2. Using the ZIF structure.
3. Low profile of 2.4mm height when mounted.
4. Supplied in the embossed taping with automatic mounter.

■ Specifications

1. Rating : 0.5A, 50V AC/DC
2. Contact Resistance : 30mΩ max., initially
3. Insulation Resistance : 1000MΩ min. at 500V DC
4. Withstanding Voltage : 500V AC (for one minute)
5. Operating Temperature Range : -40°C to +85°C

■ Material and Plating

- Housing : Thermoplastic Resin, Natural Color, 94V-0
- Cover : Thermoplastic Resin, Natural Color, 94V-0
- Contact : Cu Alloy, Au Plating
- Hold down : Cu Alloy, SnCu Plating

■ 特 長

1. 接触部の位置は上側と下側タイプがあります。
2. ZIF 構造を採用しています。
3. 実装高さは 2.4mm です。
4. 自動マウンタ対応でエンボステーピング方式による供給です。

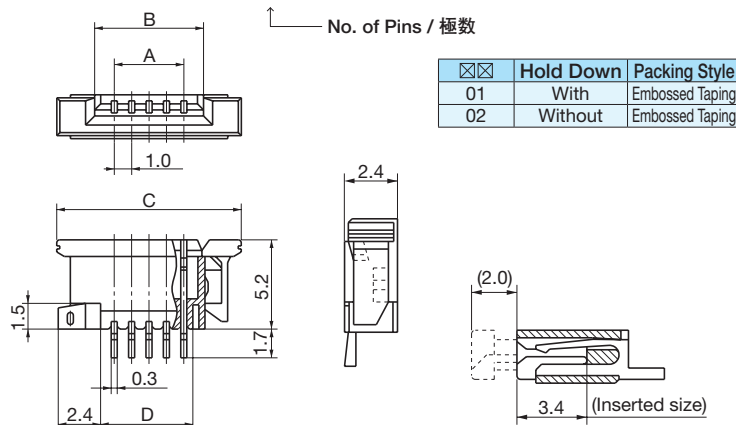
■ 仕 様

1. 定格電圧電流 : AC/DC 50V 0.5A
2. 接 触 抵 抗 : 初期 30mΩ 以下
3. 絶 縁 抵 抗 : DC 500V 1000MΩ 以上
4. 耐 電 圧 : AC 500V (1 分間)
5. 使用温度範囲 : -40°C ~ +85°C

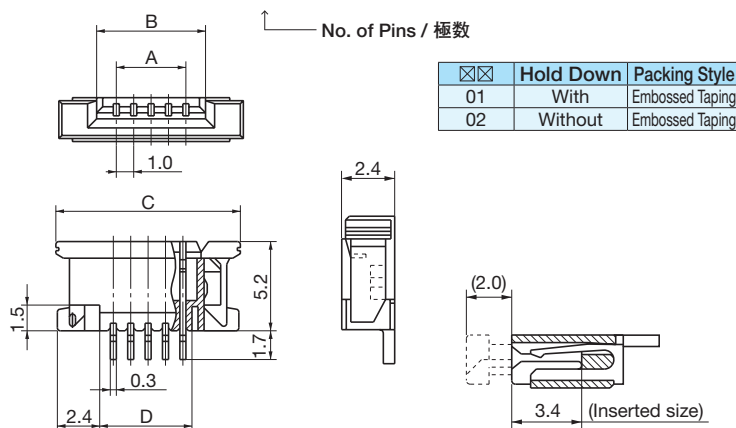
■ 材質・表面処理

- ハウジング：熱可塑性樹脂 原色 94V-0
- カバー：熱可塑性樹脂 原色 94V-0
- コンタクト：銅合金 金めっき
- ホールドダウン：銅合金 すず銅めっき

● SU Series CFP05□□-03□□F (Upper Contact)

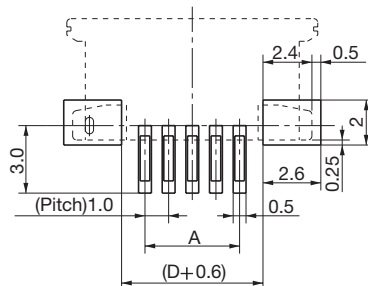


● SL Series CFP15□□-04□□F (Lower Contact)

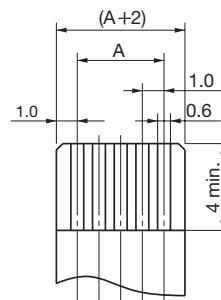


□□ No. of Pins	A	B	C	D	□□ No. of Pins	A	B	C	D
04	3.0	5.1	9.7	4.5	17	16.0	18.1	22.7	17.5
05	4.0	6.1	10.7	5.5	18	17.0	19.1	23.7	18.5
06	5.0	7.1	11.7	6.5	19	18.0	20.1	24.7	19.5
07	6.0	8.1	12.7	7.5	20	19.0	21.1	25.7	20.5
08	7.0	9.1	13.7	8.5	21	20.0	22.1	26.7	21.5
09	8.0	10.1	14.7	9.5	22	21.0	23.1	27.7	22.5
10	9.0	11.1	15.7	10.5	23	22.0	24.1	28.7	23.5
11	10.0	12.1	16.7	11.5	24	23.0	25.1	29.7	24.5
12	11.0	13.1	17.7	12.5	25	24.0	26.1	30.7	25.5
13	12.0	14.1	18.7	13.5	26	25.0	27.1	31.7	26.5
14	13.0	15.1	19.7	14.5	28	27.0	29.1	33.7	28.5
15	14.0	16.1	20.7	15.5	29	28.0	30.1	34.7	29.5
16	15.0	17.1	21.7	16.5	30	29.0	31.1	35.7	30.5

■ P.C. Board Dimension 取付基板参考図



■ Applicable FPC Dimension 適合 FPC 参考寸法 (t=0.3±0.05)



- FPC plating to recommend : Au plating
- 推奨 FPC めっき : 金めっき